

논문투고규정

1993. 5. 17 제정 / 2010. 2. 18 개정

1. 본 규정은 본 회 회지의 투고에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
2. 논문은 본 회지에 투고하기 전에 다른 학술잡지에 원보로 발표되지 아니한 것이어야 한다.
(단, Abstract, 초록 등으로 발표된 학술대회 발표자료(집)는 학술잡지의 원보로 보지 않는다.)
3. 논문의 투고는 본 회의 회원에 한한다. 단, 공동 저자나 초청 투고자는 예외로 한다.
4. 논문의 투고 일자(논문이 본회에 도착한 날)를 "접수일"로 하고 최종 심사 종료일을 "게재승인일"로 한다. 또, 그 일자를 게재된 논문에 표기한다.
5. 논문의 원고는 글 파일 또는 MS word 파일로 제출하거나, 또는 원본 1 부와 사본 2 부를 제출하여야 한다. 제출된 논문은 반환하지 않는다.
6. 투고된 원고는 연구논문(Research Paper), 특집논문(Review Paper), 속보(Communication and Notes), 연구교신 (Comments and Reply) 등의 네 가지로 구분한다.
7. 논문 작성의 언어는 국어와 영어 중 택일하고, 국어의 경우 학술용어는 영어를 병기할 수 있다.
8. 논문의 서식은 가로쓰기를 하고, 약 21cm×28cm 크기의 A4 용지에 한 줄 건너 앞 면에만 글이나 MS word 를 사용하여 타자하며, 각 면에서 2.5cm 씩 여백을 준다. 논문의 분량은 아래와 같이 제한한다.
(1) 연구논문: 표와 그림을 포함하여 15 면 이내
(2) 특집논문: 표와 그림을 포함하여 20 면 이내
(3) 속보: 표와 그림을 포함하여 7 면 이내
(4) 연구교신: 2 면 이내
9. 원고는 다음 항목별로 새로운 면(줄?)에서 시작하여야 한다.
(1) 제목, 저자명, 연구기관 및 주소(주소는 영문 표기에 한하여 작성하며, 저자의 현 소속기관이 연구당시와 다른 경우에는 현 소속기관 및 주소)를 각주에 표시하여야 한다. (소속기관이 2 개 이상일 경우에는 1, 2, 3 으로 구분하고, Corresponding author 는 †로 구분하며, Corresponding author 의 e-mail 을 각주에 명기한다.), 국문 초록(600 자 이내) 및 영문 초록(200 단어 이내), Key words (5 단어 이내) 영문주소 표기는 다음 예와 같이 작성한다. "Department of Electronics, Dankook Unievsty, 29 Anseodong, Cheonan-si, Chungnam 330-714, Korea".
(2) 본문(서론, 실험방법, 결과 및 고찰, 결론)
(3) 감사의 글
(4) 참고문헌(REFERENCES)
(5) 표
(6) 그림
(7) 원고가 영문으로 되어 있는 경우에는 초록은 영문(200 자 단어이내)으로만 하고, 본 학회지에서 별도로 정한 영어논문 작성법을 따른다.
10. 모든 표는 약 21 cm×28 cm 크기의 용지에 명료하게 작성하고, 표내의 긴 단어는 적당한 약어로 대체한 후 아래에 약어를 정의하여야 한다. 모든 표는 아라비아 숫자로 일련번호를 부여하여야 한다. (예 : Table 1.)

11. 그림 원본은 약 21 cm×28 cm 크기의 캔트지, 트레이싱지 또는 흰색용지에 흑색으로 깨끗이 그리거나 또는 600 dpi 이상의 인쇄물이어야 하며, 선의 굵기와 삽입된 글자의 크기가 1/2 로 축소된 후에도 명료하게 읽을 수 있도록 작성하여야 한다. 모든 그림은 아라비아 숫자로 일련번호를 부여하여야 한다. (예 : Fig. 1)

12. 모든 표와 그림의 설명은 영어로 하여야 한다. 표의 설명은 표의 상단에 위치시키며, 그림의 설명은 별지에 모아 작성하여야 한다.

13. 본문, 그림 및 표에 사용된 약어, 시료명, 기호 등은 그것이 처음 사용된 곳에서 한번만 정의 해주어야 한다.

14. 본문에서 영어 단어는 모두 소문자로 한다. 단, 약어는 모두 대문자로 할 수 있고, 고유명사, 표, 그림안의 단어와 약어의 괄호 안의 원어 등의 첫 자는 대문자로 한다.

15. 모든 단위는 SI 단위의 사용을 원칙으로 하며, 다른 단위가 필요하면 ()를 사용하여 표시한다.

16. 인용된 참고문헌들은 본문에 인용된 순서대로 해당 글귀의 오른쪽 어깨에 인용하며 그 차례대로 1), 2), 1,2) 또는 1-3) 으로 나타낸다.

17. 인용 문헌이 학술잡지의 경우에는 저자명, "논문 제목", 잡지명, 권수(호), 쪽수(출판년도) 순으로, 단행본이나 편집서인 경우는 저자, "제목", 책명, 편집자, 권수, 쪽수, 출판사명, 출판사 소재지(출판년도)의 순으로 명기하여야 한다.

참고문헌을 인터넷 상의 웹페이지부터 인용하는 경우에는 저자, "제목", 권수, 소재지(게재년도), 웹페이지의 순서로 명기하여야 한다. 본문이 영어가 아닌 경우에는 제목 또는 서명 뒤에 소괄호를 만들어 사용된 언어명을 명기한다(예: in Korean, in Japan). 단, 없는 항목은 생략할 수 있다.

잡지명의 약기 방식은 Chemical Abstract의 List of Periodicals에서 채택한 것을 사용하여야 한다. 본 학회지의 인용은 "J. Microelectron. Packag. Soc." 로 한다.

(1) C. S. Kim, Y. H. Lee and K. H. Song, "Reaction between Sn-3.5Ag Solder and Thin Film Metallization", J. Microelectron. Packag. Soc., 9(4), 39 (2002).

(2) J. Crank, The Mathematics of Diffusion, 2nd Ed., pp.5-10 Clarendon Press, Oxford (1975).

(3) P. V. Robock and L. T. Nguyen, "Plastic Packaging", in Microelectronic Packaging Handbook, R. R. Tummala and E. J. Rymaszewski, Eds., pp.234-237, Van Nostrand Reinhold, New York (1989).

(4) B. D. Kim, "Effect of Current Crowding on Solder Electromigration(in Kor.)," in Ph.D. Thesis, pp.50-70, Daehan University, Seoul (1990).

(5) D. Suh, C. Hwang, M. Ueshima and J. Sugimoto, "Material Design and Package-Level Reliability of a Novel Low-Temperature Solder Based on Intermetallic-Compound Phases with Superior High-Homologous Temperature Properties", Proc. 58th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), Orlando, 1265, IEEE Components, Packaging and Manufacturing Technology Society (CPMT) (2008).

(6) J. Kanter, "CO2 Labels for Motorbikes in Europe" The New York Times, (Jan. 31, 2010) from <http://www.nytimes.com>

(7) Wikipedia, Wikipedia Foundation. Inc. Jan.(2010) from <http://www.wikipedia.org/wiki/Solder>

18. 투고 시에는 소정의 심사료를 납부하여야 하며, 게재 후에는 소정의 게재료를 납부하여야 한다.

19. 원고의 초교, 재교, 및 최종 교정은 저자가 직접 하여야 한다.

20. 본 학회지에 게재된 논문의 저작권은 한국 마이크로전자 및 패키징학회에 귀속된다.

부 칙

1. 제정 일자 : 1993 년 5 월 17 일
2. 1 회 개정일자 : 2003 년 5 월 2 일
3. 2 회 개정일자 : 2009 년 4 월 1 일
4. 3 회 개정일자 : 2010 년 2 월 18 일
5. 본 규정은 2010 년 2 월 18 일부터 적용한다.